

Technology Leader in Video IP / C&M Investor Relations 2021

Chips&Media



Contents

C&M Investor Relations 2021

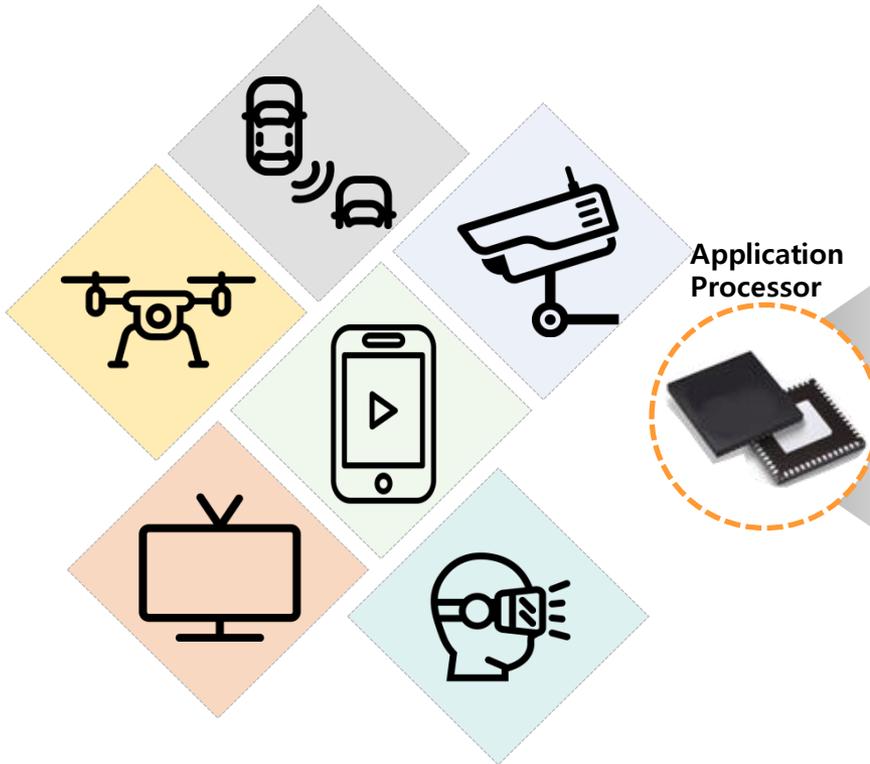


Company Overview

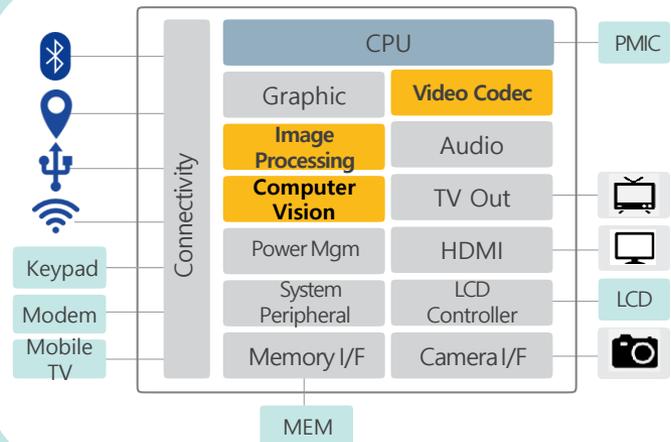
C&M Investor Relations 2021



1. Corporate Identity Designing the Future of Video Technology



반도체 설계자산 전문업체 (Silicon Intellectual Property)



프로세서와 비디오, 오디오, 그래픽, 메모리, 인터페이스 등 반도체에 내장되는 다양한 기능의 설계자산

Company Overview

C&M Investor Relations 2021



2. 비디오 IP적용 영역 및 Value Chain 자동차, 영상가전 등 광범위한 적용 분야

적용 분야 매출 구분



Company Overview

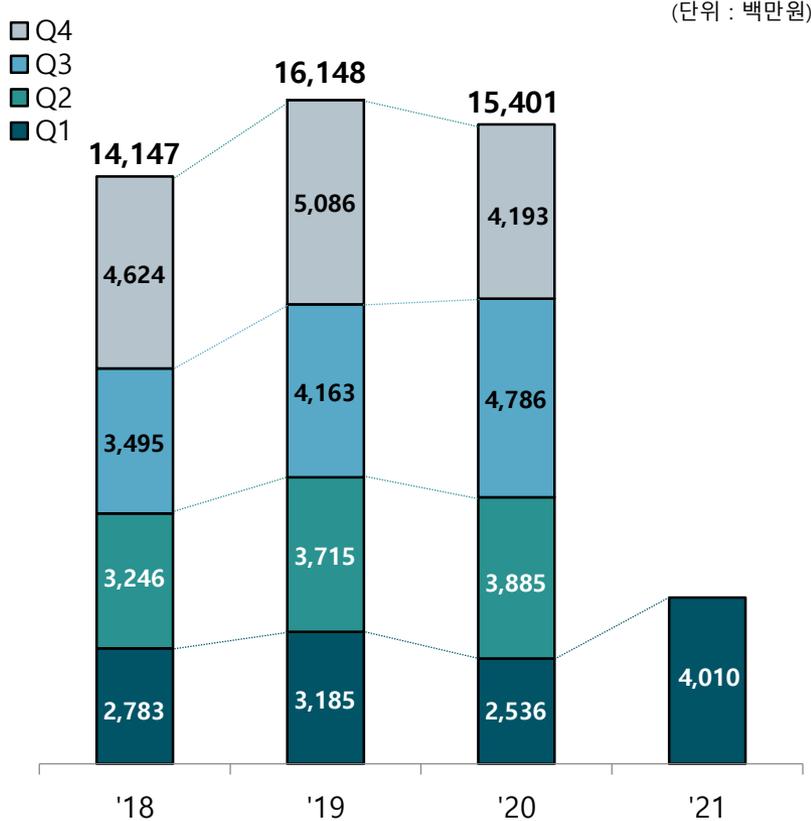
C&M Investor Relations 2021



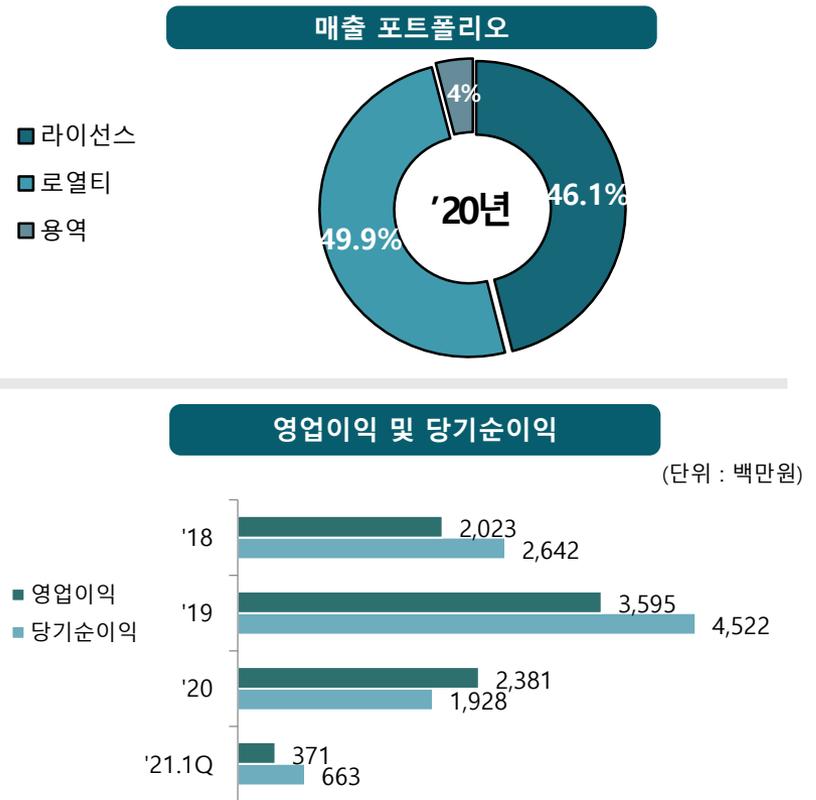
3. 경영성과 및 실적

라이선스 및 로열티 수익의 균형 있는 성장을 통한 매출 증가

❖ 매출 추이



❖ 매출 구성 및 이익



Company Overview

C&M Investor Relations 2021



4. 재무구조 특성 4無로 탄탄한 재무적 구조 구축

원가 無

매출/이익 Leverage 효과 大
원재료 조달 Risk Free

재고, 설비 無

약성재고 Risk Free
설비 유희화 Risk Free

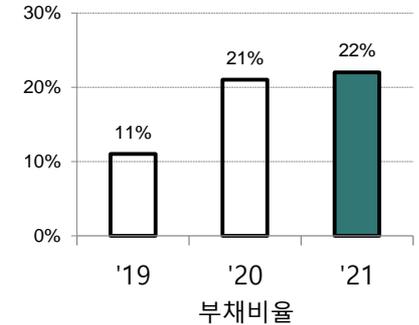
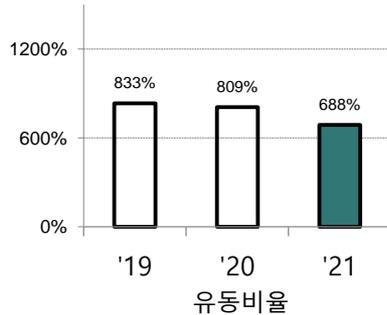
개발비 無

개발비용을 당기손익으로 인식
무형자산 손상 Risk Free

차입 無

풍부한 현금 유동성
(금융자산 240억, 무차입 경영)

Chips&Media™



Competitive Edge

C&M Investor Relations 2021



1. 강력한 고객 Reference
글로벌 Top 10 고객을 포함한 100社 이상의 다양한 고객 확보

최근 5년 누적 고객사
('16~'20)

1. NXP
2. 'S'company
3. Amlogic
4. UNISOC
5. Vimicro

Global Top-tier Customers

Global Top 10 Semi
(출처: Gartner)



Global Top 10 Fabless
(출처: Trendforce)



China Top 10 Fabless
(출처: Electronic design)

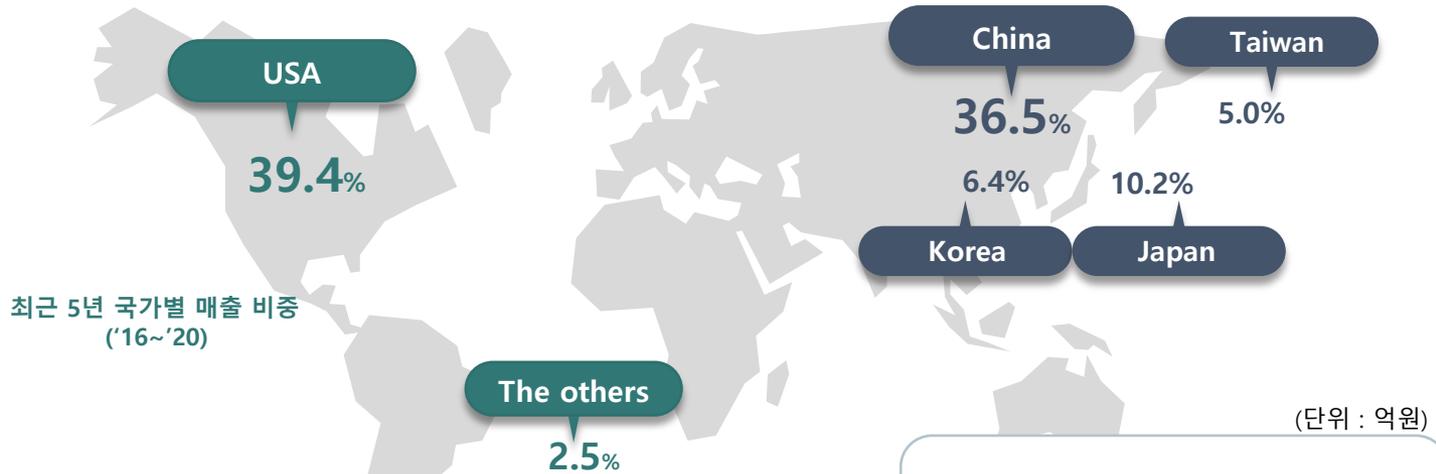


Competitive Edge

C&M Investor Relations 2021

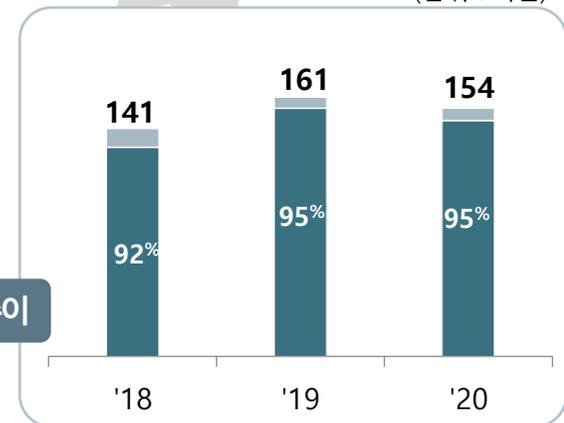


2. 다변화된 안정적 매출처 전세계 고른 매출 분포로 안정성 확보, 지역별 영업 및 기술 지원



- Seoul** HQ
- Silicon Valley** US Office
- Shanghai** China Office
- Hsinchu** Taiwan Office
- Tokyo** Japan Office

수출 비중 및 추이



Competitive Edge

C&M Investor Relations 2021



2. 다변화된 안정적 매출처 Value Chain 확대로 라이선스 증가

❖ SiFive ASIC Service/Design Share

- SiFive의 RISC-V기반 ASIC service 생태계에 IP 라이선스

• Video IP



- RISC-V
 - 저전력, 합리적 가격,
 - 빠른 설계, 유연한 디자인
- Design Service
 - SoC IP
 - Custom SoC



RISC-V members



CPU, Video, GPU, etc.

경제 정치 사회 IT

화웨이 제재-ARM 매각... 'RISC-V' 대안 급부상
SK하이닉스, ARM의 경쟁업체 '사이파이브'에 투자

파이낸셜뉴스 입력 2020.09.20 16:04 수정 2020.09.21 10:50

HOME > 뉴스



칩스앤미디어, 미국 사이파이브(SiFive)를 주축으로 한 반도체IP 업체들의 연합에 디자인웨어(DesignShare) 파트너로써 IP 제공

Competitive Edge

C&M Investor Relations 2021



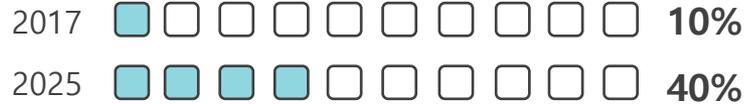
2. 다변화된 안정적 매출처 Value Chain 확대로 라이선스 증가

❖ IT 플랫폼사 Data Center, Application 자체 칩 개발

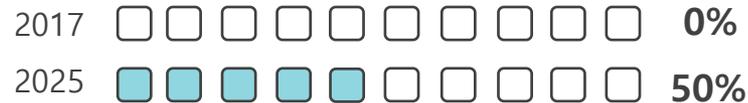
Data Center Architectures, ASIC 비율

(출처 : Yole, Mckinsey, SK증권)

Inference 추론

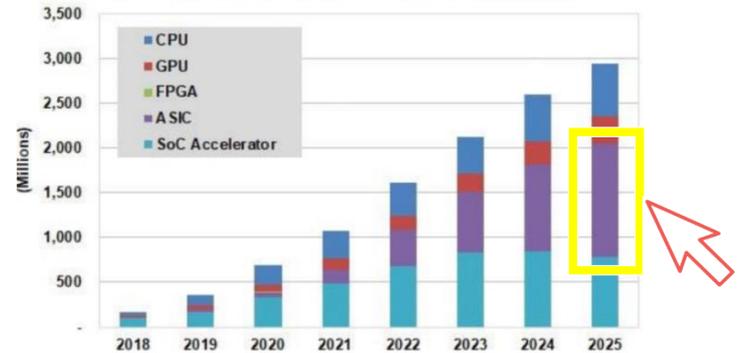


Training 훈련



Deep Learning AI 반도체 ASIC 적용 비중 증가

(출처 : Tractica)



Programmable Solution

- Flexibility
- Resource (Power, Size)



Hardware IP

- Less Flexibility
- Optimized for Special App



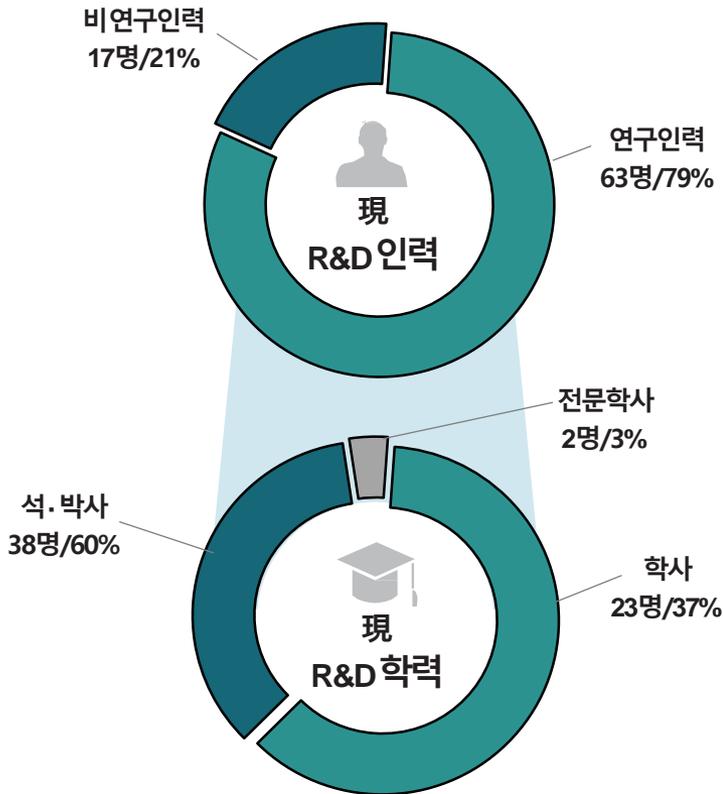
Competitive Edge

C&M Investor Relations 2021



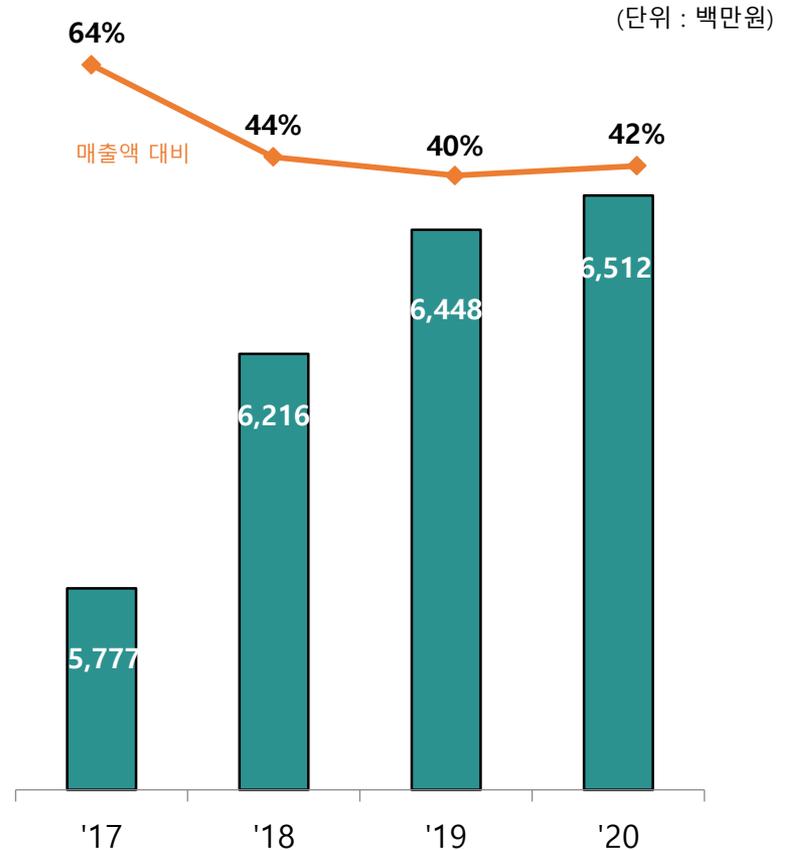
3. 우수한 인적 인프라 & 연구 개발 투자 지속적인 R&D 투자를 통한 핵심 기술력 보유

R&D 인력 현황



2021.3.31 기준

연구 개발 투자



Market Analysis

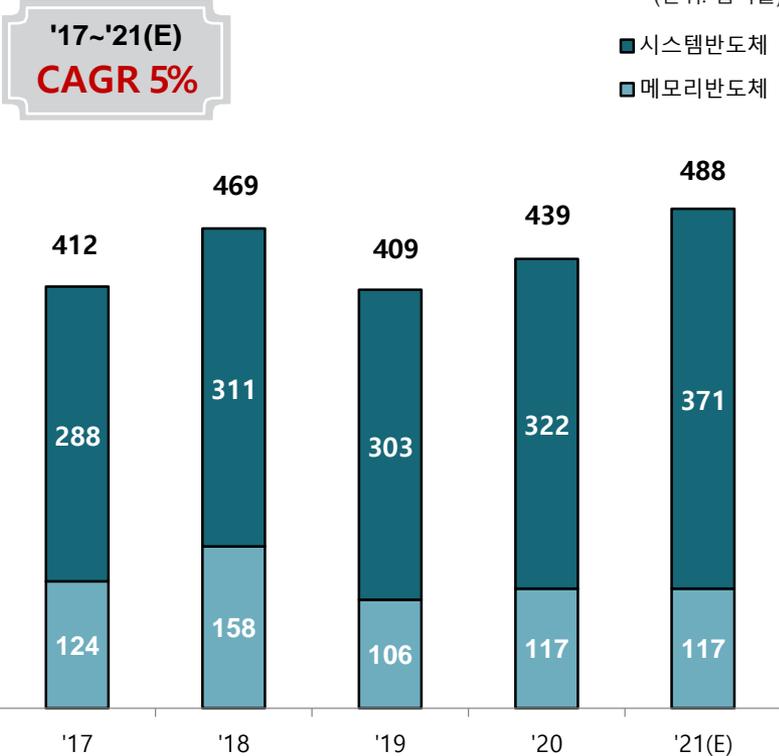
C&M Investor Relations 2021



1. 성장 중인 반도체 IP 시장 반도체 전체 시장 성장률 대비 높은 성장률을 보이는 반도체 IP 시장

❖ 세계 반도체 시장매출 추이

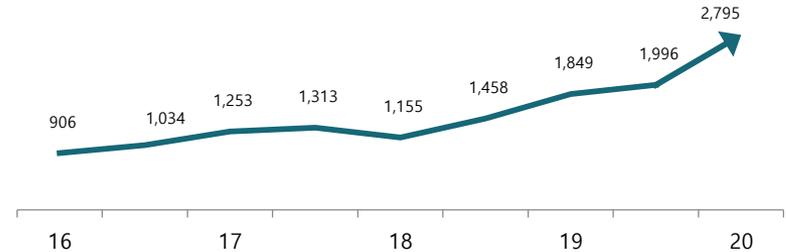
(단위: 십억불)



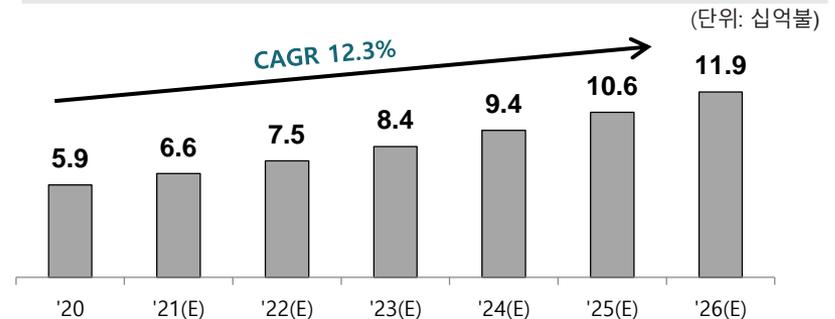
(출처: WSTS)

❖ 필라델피아 반도체 지수 PHLX Semiconductor (SOX)

나스닥, 뉴욕증시에 상장된 반도체 산업 회사 시가총액 가중지수, 반도체 관련주 가격동향 파악에 이용됨



❖ 세계 반도체 IP 시장 전망



(출처: Mordor Intelligence)

Market Analysis

C&M Investor Relations 2021



2. 전방 시장 확산

다양한 영역으로 비디오 기술 수요 확산 with AI, IoT, 5G



첨단운전자
지원시스템
[ADAS]



Automotive



자율주행
[Self-Driving]



홈 모니터링 카메라
[Home Monitoring Camera]



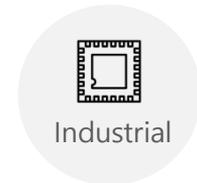
Home
Entertainment



스마트시티, 스마트홈
[Smart City, Smart Home]



드론/로봇
[Drones/Robotics]



Industrial



Image Analysis Server
Smart Camera Solution



Market Analysis

C&M Investor Relations 2021



3. 경쟁사 현황 국내 경쟁사 無, 글로벌 마켓 리더로 비디오 IP 산업 선도

❖ 세계 반도체 IP 업체 순위

(단위: 백만불)

No.	회사명	'19 매출액	'20 매출액	성장률
1	ARM	1,608	1,887	17%
2	Synopsys	717	884	23%
3	Cadence	233	277	19%
4	Imagination	87	125	44%
5	CEVA	87	100	15%
6	SST	132	97	-27%
7	Verisilicon	70	92	31%
✓	Chips&Media	14	14	1%
	Others	995	1,127	13%
	Total	3,944	4,604	17%

(출처 : IP nest)

비디오 IP 경쟁사 현황

중국 "Verisilicon"

프랑스 "Allegro"



ASIC Turnkey 서비스를
주력으로 비디오 IP 포함
다양한 IP 확보

비디오 테스트 스트림
판매에서 '13년
비디오 코덱 IP로 영역 확장

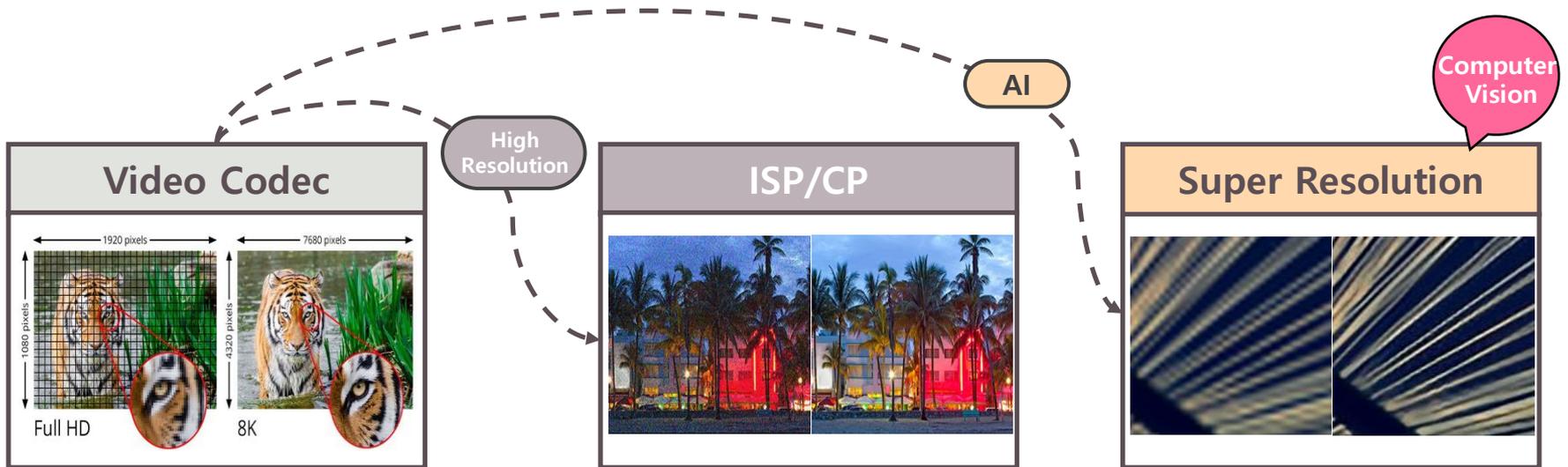
소수 회사 과점 형태로 기술 제공 중

Growth Strategy

C&M Investor Relations 2021



1. 제품 Line-up Hardware IP 기반의 고해상도 영상처리



All in one IP for various Video Standards

- HEVC, H.264, JPEG
- AV1, VP9, AVS2

Image Signal Processing

- HDR(High Dynamic Range)
- 3DNR(3Dimensional Noise Reduction)
- LDC(Lens Distortion Correction)

Deep Learning based Neural Network

- Upscaling to 4K, 8K
- Real time, Reasonable size

Growth Strategy

C&M Investor Relations 2021



2. new 인공지능 IP Computer Vision - Super Resolution

해상도가 낮은 영상을 Super Resolution 알고리즘을 통해 높은 해상도로 변환하는 기술
Deep learning을 기반으로 고화질 이미지 구현

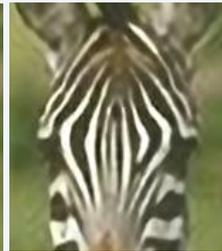
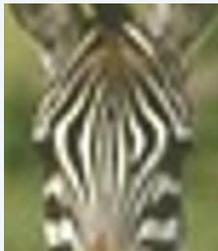
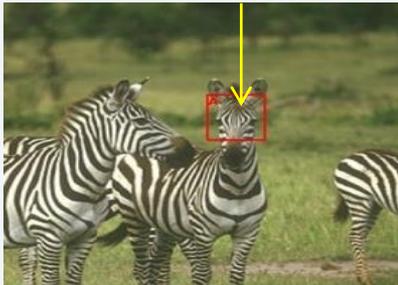
원본



Bicubic



C&M, SR



4배 \times



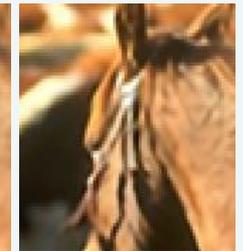
원본



Bicubic



C&M, SR



4배 \times



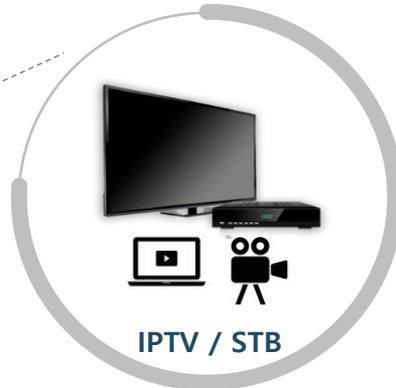
Growth Strategy

C&M Investor Relations 2021



2. new 인공지능 IP Super Resolution의 활용 - Upscaling to 4K, 8K

**Chips &
Media™**
Algorithm
& Design IP



Appendix

C&M Investor Relations 2021



1. 회사 개요

◆ 경영진

김 상 현	대표이사 CEO	경영 총괄	• Vaughn College 항공전자학과 • 텔스전자
이 호	부사장 CFO	재무 총괄	• 서울대 경제학과 • 삼성물산(주) 재경팀
강 원 모	상무 CHRO	인사 총괄	• 중앙대 경영학과 석사 • BOE 하이디스
오 진 흥	이사 CTO	R&D 총괄	• 서울대 전기공학부 석사 • 삼성전자(주)



49.63억원
자본금

사업영역



비디오 IP

설립일



2003년 3월 6일

Appendix

C&M Investor Relations 2021



2. 연혁

설립기

- 회사 설립 / 반도체 IP 제공 -

2003

- 회사 설립
- 기업부설연구소 인증

2004

- 국내 첫 비디오 IP 라이선스
- 벤처캐피탈 투자 50억원 유치

2005

- 해외 첫 비디오 IP 라이선스

2006

- 최초 로열티 수익 발생

성장기

- HD급 / Full HD급 비디오 IP 개발 -

2007

- 기술혁신중소기업(INNO-BIZ)인증
- Full HD급 멀티 표준 비디오 디코더 IP 출시

2008

- 칩스앤미디어와 씨앤엠마이크로 인적 분할
- 대표이사 김상현 취임

2009

- 중국 상하이 대표처 (연락사무소) 개소
- 최대주주 변경 (텔레칩스)

2011

- 중국 상하이 대표처 법인 전환
- 대만 신주 영업사무소 개소

2012

- 일본 도쿄, 미국 산호세 영업사무소 개소
- 지식경제부 주관 세계일류상품 선정

2013

- 한국거래소 코넥스 시장 상장

2014

- UHD급 비디오 코덱 IP 출시

도약기

- 비디오 IP 시장의 Leader -

2015

- 한국거래소 코스닥 시장 이전 상장
- 문화체육관광부 여가친화기업 인증

2017

- ISP IP 출시

2018

- 미국 산호세 법인 전환
- Computer Vision IP 출시

2019

- 8K UHD급 비디오 코덱 IP 출시
- 세계 최초 커머셜 AV1 IP 출시

2020

- 딥러닝 기반 Super Resolution IP 출시

Appendix

C&M Investor Relations 2021



3. 요약 재무제표

❖ 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021.1Q
유동자산	23,837	26,615	24,982	22,552
비유동자산	8,020	9,245	14,788	17,451
자산총계	31,857	35,860	39,770	40,003
유동부채	2,163	3,192	3,087	3,280
비유동부채	1,150	575	4,068	3,926
부채총계	3,313	3,767	7,155	7,206
자본금	3,851	3,851	4,964	4,964
자본잉여금	15,577	15,577	14,465	14,465
기타자본구성요소	(1,684)	(1,685)	(1,701)	(1,701)
기타포괄손익누계	(462)	(463)	(387)	(386)
이익잉여금	11,262	14,813	15,274	15,456
자본총계	28,544	32,093	32,615	32,798

❖ 요약 연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021.1Q
영업수익	14,147	16,148	15,401	4,010
영업비용	12,124	12,553	13,020	3,639
영업이익	2,023	3,595	2,381	371
기타영업외수익	349	306	312	348
기타영업외비용	217	215	990	9
금융수익	302	509	452	85
금융비용	21	-	76	110
법인세차감전순이익	2,435	4,195	2,080	685
법인세비용	(207)	(326)	151	22
당기순이익	2,642	4,521	1,928	663
기타포괄손익	(632)	(438)	(263)	2
총포괄이익	2,010	4,083	1,665	665

